

苏州日月新半导体有限公司
IC 产品封装测试生产扩建项目
竣工日期公示

我公司依照建设项目环保审批意见和环境影响报告表的要求，于2016年12月完成IC产品封装测试生产扩建项目及配套环保设施施工，在项目工程设计、建设和运营过程中，落实《环境影响报告表》中提出的各项环保要求，并严格执行三同时制度，按照规范设置各类排污口标识，合理布局，采用低噪音、低震动的设备，加强环境风险的管理，落实报告表中各项风险防范措施，防止环境污染，现依照建设项目竣工环境保护验收暂行办法规定公示苏州日月新半导体有限公司IC产品封装测试生产扩建项目竣工日期。

本项目于2016年12月竣工。

联系人：王德翠

联系电话：18662290018

公示日期：2019-01-15

